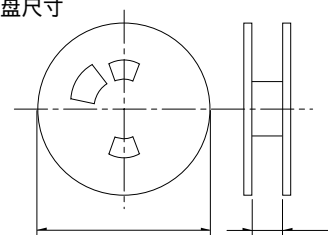










产品阵容新加入了与SKPM保持同一端子形状的3.6N品。

最小订货单位 (pcs.)

卷盘尺寸



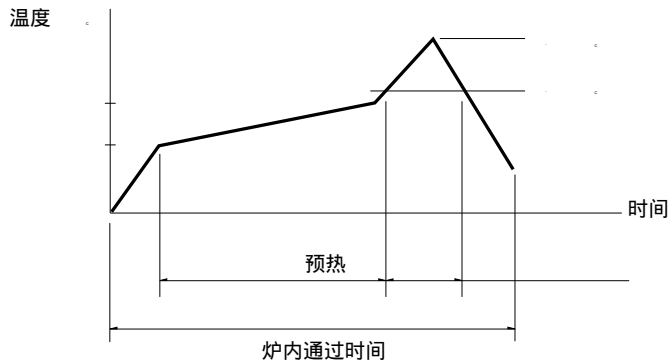
									
电性能	最大额定	↕	↕		↕	↕	↕	↕	↕
	最小额定								
	绝缘电阻								
	耐电压								
耐久性能	耐振性能								
	寿命		☆	★ ₂	★ ₂	★ ₂	★ ₃	★ ₃	★ ₃
耐环境性能	耐寒性能								
	耐热性能								
	耐湿性能								
页									

W 横尺寸 不含端子部的最外围尺寸。
 D 纵尺寸 不含端子部的最外部尺寸。
 H 有高度的尺寸 多种类时其中最小尺寸。

注

- 关于车用等大温度范围的要求，将个别作出应对，因此如有要求的，请予我公司商谈。
- 表中的 ☆ 符号表示适用于系列内的全部产品。

回流焊时
适用于表面贴装型
温度分布



- 注**
- 关于详细条件, 请于本公司的产品规格书进行确认。
 - 根据贴面焊槽的种类, 条件不同结果不同, 请事先充分进行确认之后使用。

自动浸焊时
适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100 max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260 max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

项目	条件
焊接温度	350 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

□□□□, □□□□ 系列

项目	条件
焊接温度	360 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

□□□□, □□□□, □□□□ 系列

项目	条件
焊接温度	350 max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.



□□□□Top push型, □□□□ 系列

项目	条件
助焊剂附着量	

- 注**
- 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
 - 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
 - 进行第 2 次焊接时, 应在开关恢复到常温之后进行。
 - 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂 (株式会社 田村製作所 EC-19S-8 同等品)。